

'2025 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)' 추진계획(안)

'첨단 패키징'의 중요성이 강조됨에 따라 지자체 주도의 반도체 산업 전시회를 개최하여 글로벌 기술 리더십 성장 지원을 통한 기업 경쟁력 강화

I 추진배경

○ 반도체 패키징 산업 동향

- (산업동향) 전공정 미세화 한계로 **첨단 패키징 산업 중요성 증대**
- (기술동향) 고성능·저전력·소형화 기술의 발전과 함께, 초미세화 한계 도달에 따른 **첨단 패키징 등 대안 기술에의 관심 증가**
- (시장동향) 시장 규모 6년간 **2배 이상 성장**(연평균 13%) **전망***
 - * ('22년) 443억 달러 → ('28년) 786억 달러 (출처 : YOLE Intelligence 2023)
- (정부동향) 첨단 패키징 선도기술 개발사업(2,744억원) **예비타당성 통과**('24.6.)

⇒ (시사점) **첨단 패키징** 산업 급성장에 따른 도내 기술경쟁력 강화 필요**

** 패키징 : 칩 제조 후 신호전달, 전력공급, 열 방출 및 관리와 함께 외부환경에 보호하는 기술

○ 경기도 산업 여건

- 도내 패키징 앵커기업과 관련한 기업 60% 이상 소재(중견 9개 중 5개 소재)
- 세계 4대 소부장 외투기업 및 LG이노텍, 대덕전자 등 패키징 기업 다수 소재
- ⇒ (도 추진방향) **지자체 주도 반도체 패키징 특화된 산업전을 개최함으로써 도내 패키징 산업 육성을 위한 기업 간 협력 네트워크 조성**

※ 관련공약 : 6. 반도체 글로벌 첨단산업 육성

II 사업개요

□ 행사개요

○ 행 사 명 : **2025 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)**

○ 기 간 : '25. 8. 27.(수) ~ 8. 29.(금) (3일 간)

○ 장 소 : 수원컨벤션센터

○ 주 최 : **경기도·수원시**(공동개최)

○ 주 관 : (재)수원컨벤션센터, 제이엑스포, 전자신문사

○ 전시규모 : 150개사 350부스

※ 전시품목 : 반도체 패키징 및 테스트 장비, 반도체 패키징 소재 및 부품, 반도체 패키징 기술 솔루션, 기타 웨이퍼 가공 소재, 부품 장비 등

○ 행사구성 : 산업전시회, 반도체 국제포럼, 기술세미나, 부대행사* 등

* 개막식, 기조연설, 국제 반도체 경영진 서밋(ICES), 수출상담회, 채용박람회 등

III

운영계획

□ 행사구성(안)

	1일차(8.27)	2일차(8.28)	3일차(8.29)
산업전시회 (1층 전시장)	차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS 2025)		
국제회의 (동시개최)	ISES Korea 2025(국제 반도체 경영진 서밋)		
부대행사	·개막식 ·반도체 패키징 트렌드 포럼 ·수출상담회 ·기업별 기술 세미나 ·연구기관 세미나	·컨퍼런스 ·기업별 기술 세미나 ·연구기관 세미나	·인재육성 프로그램 ·기업별 기술 세미나 ·연구기관 세미나

□ 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)

- 기간/장소 : 2025. 8. 27.(수) ~ 8.29(금) / 수원컨벤션센터 전시홀
- 주요내용 : 반도체 후공정 전문 전시회 개최
- 전시품목 : 반도체 패키징 및 테스트 관련 장비, 소재, 부품, 기술 등
- 전시규모 : 150개사 350부스(예정 규모)
- 전시회 배치도(안)

Advanced SEMICONDUCTOR PACKAGING Show



□ 경기도관 / 경기도 팹리스 파빌리온관 운영(안)

- 기간/장소 : 2025. 8. 27.(수) ~ 8.29(금) / 1층 전시홀 내 입구
- 목 적 : 경기도 반도체 관련 정책홍보 및 도내 협력사업 기술 홍보
- 사업예산 : 70백만원(도비 100%)
- 규 모 : 15부스 내외(예산 한도 내)
- 운영기관 : 차세대융합기술연구원

□ 반도체 패키징 트렌드 포럼(안)

- 추진배경 : 도내 패키징 기업의 전문성 향상 및 글로벌 성장기반 마련을 위한 국제 전문포럼 개최
- 일시/장소 : 2025. 8. 27.(수) / 수원컨벤션센터 컨벤션 3홀
- 참여대상 : 반도체 기업의 중간 관리자급
- 포럼주제 : 지능형반도체(AI)와 반도체 산업의 밸류체인(예정)
- 주요연사 : 반도체 산업을 선도하는 글로벌 기업의 주요 임직원
- 세부일정(안)

시 간	세부내용	비 고(주제)
10:00-11:00	세션 1 발표(40분) & 질의응답(20분)	반도체 설계
11:00-11:20	쉬는시간	
11:20-12:20	세션 2 발표(40분) & 질의응답(20분)	제조 - 전력 인프라
12:20-14:00	네트워킹 및 쉬는 시간	
14:00-14:40	개막식	
14:40-15:00	정돈 및 쉬는 시간	
15:00-16:00	세션 3 발표(40분) & 질의응답(20분)	후공정 - 실리콘포토닉스
16:00-16:20	네트워킹 및 쉬는 시간	
16:20-17:20	세션 4 발표(40분) & 질의응답(10분)	후공정 - 파운드리

□ 수출상담회(안)

- 일시/장소 : 2025. 8. 27.(수) / 수원컨벤션센터 전시홀
- 규 모 : 해외 바이어 5명(초청), 국내 바이어 5명, 국내 기업 100개사 예정
- 추진방법
 - (해외 바이어) 표준화 포럼 연사로 참여하는 주요 기업의 바이어와 연계, 실질적 계약 상담으로 이루어질 수 있는 상담회 개최
 - (국내 바이어) 국내 대기업 & 해외기업의 국내 지사 담당자 초청 상담회 진행
 - (운영방안) 경기도 경과원 또는 KOTRA 등 수출상담 전문기관과 협업 추진

□ 기타 부대행사

○ 부대행사 운영계획(안)

장 소	1일차(8.27.)	2일차(8.28.)	3일차(8.29.)
컨벤션 1홀		[소부장 융합포럼] 10-17시	[반도체아카데미] 10-17시
컨벤션 3홀	[반도체 패키징 트렌드 포럼] 10-16시 [개막식] 14시	[ISES Korea] 08-20시	[ISES Korea] 08-16시
전시홀	[산업전 운영] 10-17시		
	[VIP 전시장 관람] 15시		
회의실	[기술세미나] 10-17시		

○ 개막식

- 일시/장소 : '25. 8. 27.(수) 14:00 ~ 15:00 / 컨벤션 3홀
- 주요내용 : 주요내빈 소개, 개회사, 축사, 테이프 커팅식, 전시장 관람 등

○ 기술세미나

- 일시/장소 : '25. 8. 27.(수) ~ 8. 29.(금) / 회의실
- 주요내용 : 기업별 기술세미나, 연구기관 세미나 개최
소부장 융합포럼(한국마이크로전자패키징연구조합 등) 추진
- 참석대상 : 반도체 업계 관계자 및 취업준비생 등

○ 산학연계 채용설명회 추진

- 일시/장소 : '25. 8. 28.(목) ~ 8. 29.(금) / 1층 로비
- 사업대상 : 취업준비생 또는 재취업, 이직 희망자
- 주요내용 : 기업별 채용 설명회, 멘토링 프로그램, 반도체 아카데미 프로그램, 구인·구직 매칭 추진 등

○ (동시개최) 글로벌 반도체 경영진 서밋(ISES) 코리아 2025

- 일시/장소 : 2025. 8. 28.(목) ~ 8. 29.(금) / 컨벤션 3홀
- 주 최 : (재)수원컨벤션센터, ISIG(국제반도체산업그룹)
- 참여대상 : 반도체 기업 경영진 150명(삼성, SK하이닉스 등)
- 주요연사 : 반도체 산업을 선도하는 글로벌 기업 대표

■ ISES USA 2025

- 일시/장소 : '25. 4. 8. ~ 4. 9. / 미국 실리콘밸리
- 참여기업 : 삼성전자, SK하이닉스, 구글, 엔비디아, 브로드컴, 마이크론, AMD 등
- 주 제 : AI혁신, 반도체 발전의 새로운 물결을 이끌다
- 주요내용 : 차세대 패키징·HBM(고대역폭메모리), AI 솔루션 등 기술 소개

IV

시·군 협조사항

○ 시·군 주관 공동관 참여

- 관내 반도체 기업과 함께 공동관 운영
- 산·학·연·관(관내 대학, 연구기관, 산업진흥원 등)에 적극 홍보 및 공동 참여
- 시·군 공동관 수요조사[붙임3(서식)] 제출 : **'25. 3. 31.(월)까지**

※ 공동관 운영 혜택 : 참가비 할인 20%(4개 부스 이상 참가 시)

(단위 : 천원/부스 당)

구분	독립 부스	기본 부스	프리미엄 부스	비 고
정상가	2,520	2,970	4,020	부가세 별도
20% 할인	2,016	2,466	3,516	(1부스 = 3m×3m=9㎡)

* 문의처 : (주)제이엑스포 (02-6285-9131)

V

기대효과

- 반도체 산업전시회 개최를 통한 도내 관련 기업들의 성장 기회 확대
- 첨단 패키징 기술 홍보를 통한 도내 반도체 고급 전문 기술인력 유입 도모
- '반도체 메가 클러스터' 구축과 연계, 도 전역 반도체 공정 생태계 조성
- 국내 유일 지자체가 공동주최하는 전시회로서, 도-시·군 간 협력체계 마련을 통한 도내 반도체산업 경쟁력 강화 기여

- 붙임 1. 2024년 사업 결과 보고 1부.
2. ISES USA 2025 보도자료 1부. 끝.

□ 행사개요

- 행 사 명 : 2024 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)
- 기간/장소 : 2024. 8. 28.(수) ~ 8. 30.(금) / 수원컨벤션센터
- 주최/주관 : 경기도, 수원시(공동개최) / 수원컨벤션센터, 제이엑스포, 전자신문사
- 전시규모 : 168개 기업·기관 328부스
※ 경기도관 6개 기업 12부스, 팹리스관 4개 기업 9개 부스 참석(차세대융합기술연구원 주관)
- 행사구성 : 산업전시회, 국제포럼(개막행사 포함), 부대행사(컨퍼런스, 기술세미나, 채용박람회, 구매상담회 등)
- 사 업 비 : 170백만원

□ 행사결과

- ① 개막행사 : 내빈 소개, 인사 말씀, 축사, 기조연설, 협력 세리머니, 테이프 커팅식, 전시장 관람

- 주요 참여

- (기 업) 삼성, SK하이닉스, 팹트론, 레조낙, 에스제이이노테크, 미르기술, 제우스 등
- (지자체) 수원시, 평택시, 부천시 등
- (기 관) 차세대융합기술연구원, 한국나노기술연구원, 성균관대 산학협력단, 아주대 산학협력단, 경기대학교 산학협력단 등



인사 말씀

협력 세리머니(퍼포먼스)

테이프 커팅식

- ② 국제포럼 : 5개 세션 국내외 연사 초청 '반도체 패키징 트렌드 포럼' 개최
- ③ 전 시 회 : 반도체 첨단 패키징(후공정) 전문 산업전시회 개최(8.28.~8.30.)
- ④ 부대행사 : 전문 컨퍼런스, 기술세미나, 채용박람회, 구매상담회 등 개최

□ 주요성과

- (전체 참관객) 11,440명 (컨퍼런스 및 세미나) 1,689명 (부대행사) 12개 동시 개최
 - (컨퍼런스) 반도체 패키징 트렌드 포럼(327명/5개 세션), 소부장 융합포럼(280명)
 - (기술세미나) 참가기업 및 기관(용기원, 나노원, 실장협회 등) 세미나 개최(1,082명)
 - (구매상담회) 바이어 15개사, 참가기업 43개사, 구매상담 61건, 계약추진액 5억원
 - (채용박람회) 채용기업 19개사 및 구직자 280명 참가(용기원, 반도체산업협회)

이투데이

“차세대 HBM·패키징 기술 선봬”...삼성·SK, 美 ‘ISES 2025’서 나란히 발표

입력 2025-02-04 05:00

4월 美 실리콘밸리서 개최
구글·엔비디아 등도 발표



▲국제반도체산업그룹(SIG)이 4월 8~9일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 '글로벌 반도체 경영진 서밋(ISES) USA 2025'를 개최한다. (자료출처=SIG)

삼성전자와 SK하이닉스가 미국에서 열리는 글로벌 반도체 포럼에 나란히 참가해 차세대 인공지능(AI) 솔루션 및 기술을 선보인다. 특히 양사는 올해도 고대역폭메모리(HBM) 개발에 박차를 가하고 있는 만큼 현재 기술 현황과 미래 과제 등을 소개할 것으로 예상된다.

3일 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 4월 8~9일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 열리는 '글로벌 반도체 경영진 서밋(ISES) USA 2025'에 참가한다.

ISES는 국제반도체산업그룹(SIG)이 주최하는 반도체 전문 국제포럼으로, 주요 글로벌 반도체 기업의 경영진이 연사로 참여해 첨단 반도체 산업의 주요 신기술과 미래 방향성을 논의하는 행사다.

이번 행사는 'AI 혁신: 반도체 발전의 새로운 물결을 이끌다'라는 주제로 열린다. 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 기업뿐만 아니라 브로드컴, 구글, 엔비디아, 마이크론, AMD 등 글로벌 반도체 및 빅테크 기업 주요 임원진들도 자사의 차세대 AI 기술에 관해 발표할 예정이다.

삼성전자에서는 빈센트 김 미국 디바이스솔루션(DS) 패키징 담당 부사장이 'HBM 개발과 메모리 확장'을 주제로 패널로 무대에 오른다. 올해 HBM 시장에서 주도권을 잡기 위해 사활을 걸고 있는 만큼, 차세대 HBM 제조 기술 및 제품 개발 현황 등에 관해 발표할 것으로 보인다.

... 중략...

특히 SK하이닉스는 이번 행사에서 업계 게임체인저로 꼽히는 '하이브리드 본딩' 패키징 기술 개발 현황도 발표할 것으로 점쳐진다.

하이브리드 본딩은 과 칩 사이 연결 부위인 범프없이 구리로 직접 접합시키는 패키징 방식이다. 이를 통해 칩 전체 두께가 얇아져 고단 적층을 할 수 있다. SK하이닉스는 HBM4E 제품부터 본격적으로 하이브리드 본딩을 적용할 예정이다.

이강욱 SK하이닉스 패키지개발 담당 부사장은 지난해 10월 서울 코엑스에서 열린 '반도체대전 2024' 기조연설에서 "패키징을 지배하는 자가 앞으로 반도체 시장을 지배할 것이라고 생각한다. 향후 기업의 생존을 좌우하는 형태까지 될 것"이라고 강조하면서 향후 패키징에도 중점을 두겠다고 강조하기도 했다.

한편 ISES는 올해 한국에서도 개최된다. 8월 27~28일 수원컨벤션센터에서 차세대 반도체 패키징 산업전과 함께 대규모로 열릴 계획이다.